



软件定义激光
认知赋能智造

激光焊接头光束质量分析仪 BQA-1064-LPH

产品简介

激光焊接头光束质量分析仪BQA-1064-LPH专为评价高能聚焦激光光束质量设计，可实时测量激光加工头输出光束的静态与动态光束质量，精确评估强度轮廓、光束宽度、形状、焦点位置、光束质量 M^2 、发散角、能量分布、焦深等关键光学指标，是激光焊接、切割等领域的理想选择。

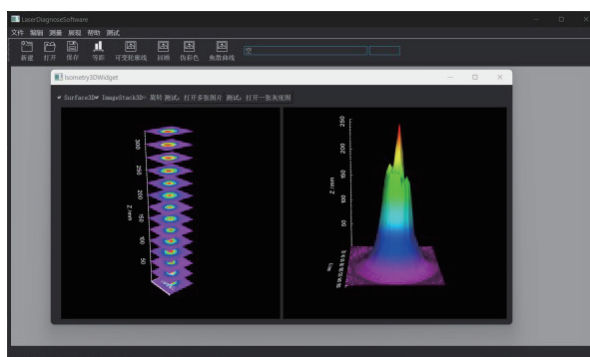
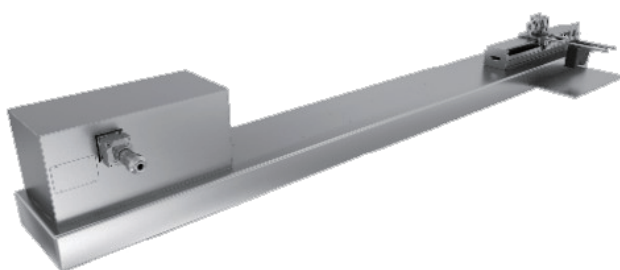


图17 激光焊接头光束质量分析仪内部结构和软件界面

产品用途

1. 场镜输出激光光束质量测量
2. 激光焊接头光束质量测量
3. 激光切割头光束质量测量

技术优势

1. 广泛兼容性：支持500mm行程，适配各种焦距的加工镜头。
 2. 集成功率检测功能：最高支持2万瓦的激光功率，满足高功率应用需求。
- 产品用于激光焊接、切割、打标等行业，是确保激光加工质量和效率的必备工具。





技术指标

产品型号	BQA-1064-LPH
主要测试参数精度	
激光焊接头聚焦焦点位置精度 (mm)	0.01
激光焊接头聚焦光斑的形貌分布精度 (%)	<1
激光焊接头的光束质量准确度 (%)	<2
输入激光要求	
焊接头输入功率 (W)	10~20000
测试波长范围 (nm)	350-1100
聚焦透镜耦合输出要求 (mm)	200-2000
测试设备参数	
测试光斑直径测量范围 (mm)	0.1-5
聚焦光束束腰扫描范围 (mm)	500
光斑形貌分析仪动态范围 (dB)	60
帧光斑形貌分析仪动态率 (FPS)	61
光斑形貌分析仪分辨率 (MPix)	1.3
光斑形貌分析仪CMOS尺寸 (mm)	6.8×5.4

